承　认　书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客　　户：佳 士 达
CUSTOMER

品　　名：D-SUB R/A 12.5H CONN.
DESCRIPTION

客户料号：2K.24013.A15
BUYER P/N.

DLK 料号：DSB4WD-15LM1YN3P
DLK P/N

客户承认意见栏 CUSTOMER APPROVED BY

深圳市德力康电子科技有限公司
SHENZHEN DLK ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.
地址：深圳市西丽镇大磡村王京坑 92 号
TEL：0755-88841180　FAX：0755-26994489
昆山德力康电子科技有限公司
KUNSHAN DLK ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD
地址：昆山市淀山湖镇黄浦江南路 278 号
TEL：0512-57498666　FAX：0512-57498555

核准		审核		制作	丁 沁	日期	2015 年 02 月11 日

目　录

Directory

1. 封面

Cover

2. 目录

Directory

3. 履历表

Resume

4. 图面

Drawings

5. 材质清单

Material list

6. UL 黄卡

UL Card

7. 规格书

Specification

8. 环境管理物质不使用证书

Environmental management material don't use certificate

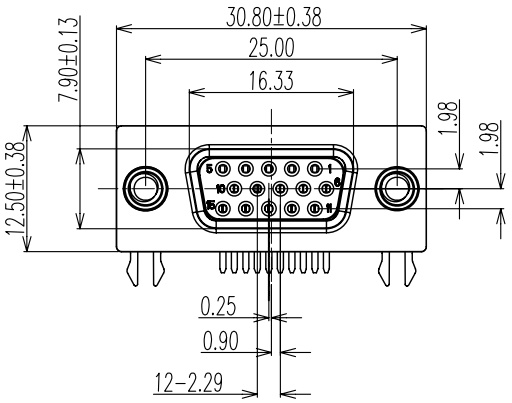
COMPONENT SPEC VERSION RECORD

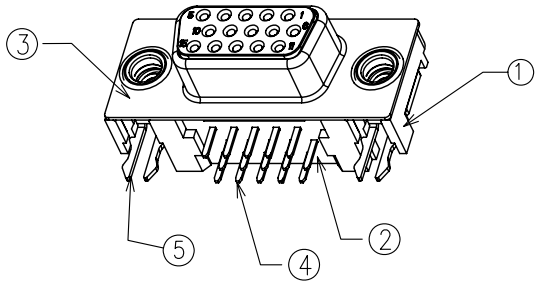
CUSTOMER PART NO.	2K.24013.A15	DLK PART NO.	DSB4WD-15LM1YN3P

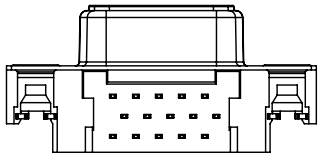
VER	MINUTE OF CHANGES	DLK CHECK	RELEASE DATE
A	CHECKED AND RELEASED	丁 沁	2015-02-11

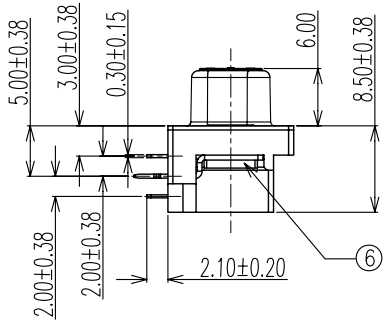
符合"DLK环境管理物质技术标准"

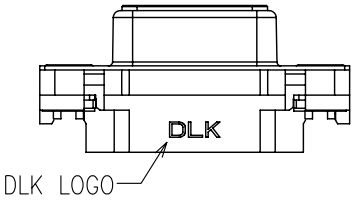
工程变更通知单 ECN(DCN) NO.	版本 REV	日期 DATE	说明 DESCRIPTION	变更 CHANGE	核准 APPRO.
————	XO	20150211	NEW	——	——

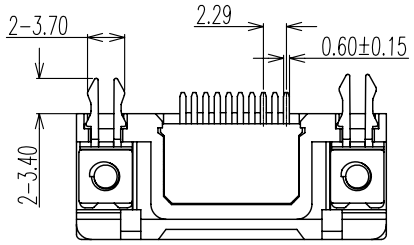






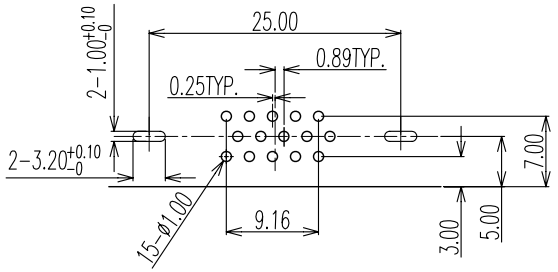






DSB4W D-15 L M1 Y N3 P
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

① PRODUTION CODE（产品编码）:
DSB4W: D-SUB-15PIN(3.0) CONN
② CHARACTER（特征）:
D: DIP TYPE
③ POSITION（位数）:
15: 15PIN
④ COLOR OF HOUSING(本体颜色）:
L: BLUE COLOR
⑤ PLATING OF CONTACT(端子电镀）:
M1 :GOLD FLASH AND TIN PLATED（镀雾锡）
⑥ PACKAGE(包装）:
Y :TRAY PACKAGE
⑦ PLATING OF SHELL(铁壳电镀）:
N3:NI PLATD
⑧ TYPE:
P：无螺丝(后盖全封)



PCB LAYOUT(T=1.20mm)
TOP VIEW

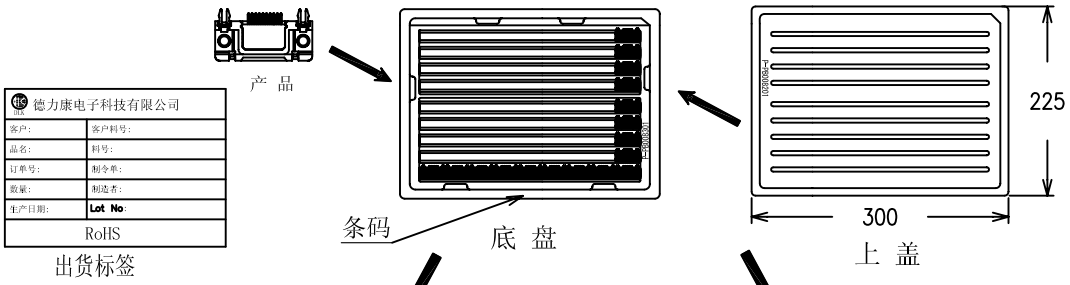
NO.	ITEM	Q'TY	DESCRIPTION	FINISH
6	RIVET	2	COPPER ALLOY	Ni PLATED
5	BOARD LUCK	2	FERROALLOY	Tin PLATED
4	Contact	15	COPPER ALLOY	Au AND Tin PLATED
3	Shell	1	FERROALLOY	Ni PLATED
2	Cover	1	PBT+GF30	UL94V-0,Black
1	Housing	1	PBT+GF30	UL94V-0,BLUE

GENERAL TOLERANCE UNLESS OTHERWISE NOTED	
Angle	±5°
X.	±0.50
.X	±0.35
.XX	±0.25
.XXX	±0.15
A4	

德力康电子科技有限公司
DLK DELIKANG ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD

C	名称 TITLE:	D-SUB R/A 12.5H CONN	料号 PART NO:	DSB4WD-15LM1YN3P	
	档案名称 FILE NAME.	C-DSB4W-00-0P	PART NO: (OLD)	——	
DRAWING	王永辉	CHECKED		APPROVED	
UNIT:	mm	SCALE	1:1	SHEET: 1 of 1	

工程变更通知单 ECN(DCN) NO.	版本 REV	日期 DATE	说明 DESCRIPTION	改变 CHANGE	承认 APPRO.
———	X0	20150130	NEW RELEASE	———	———



德力康电子科技有限公司	
客户:	客户料号:
品名:	料号:
订单号:	制令单:
数量:	制造者:
生产日期:	Lot No:
RoHS	

出货标签

包装说明:

1.数量:

一盘=90Pcs,

一箱装两叠=1530(17盘)+1530(17盘)=3060Pcs

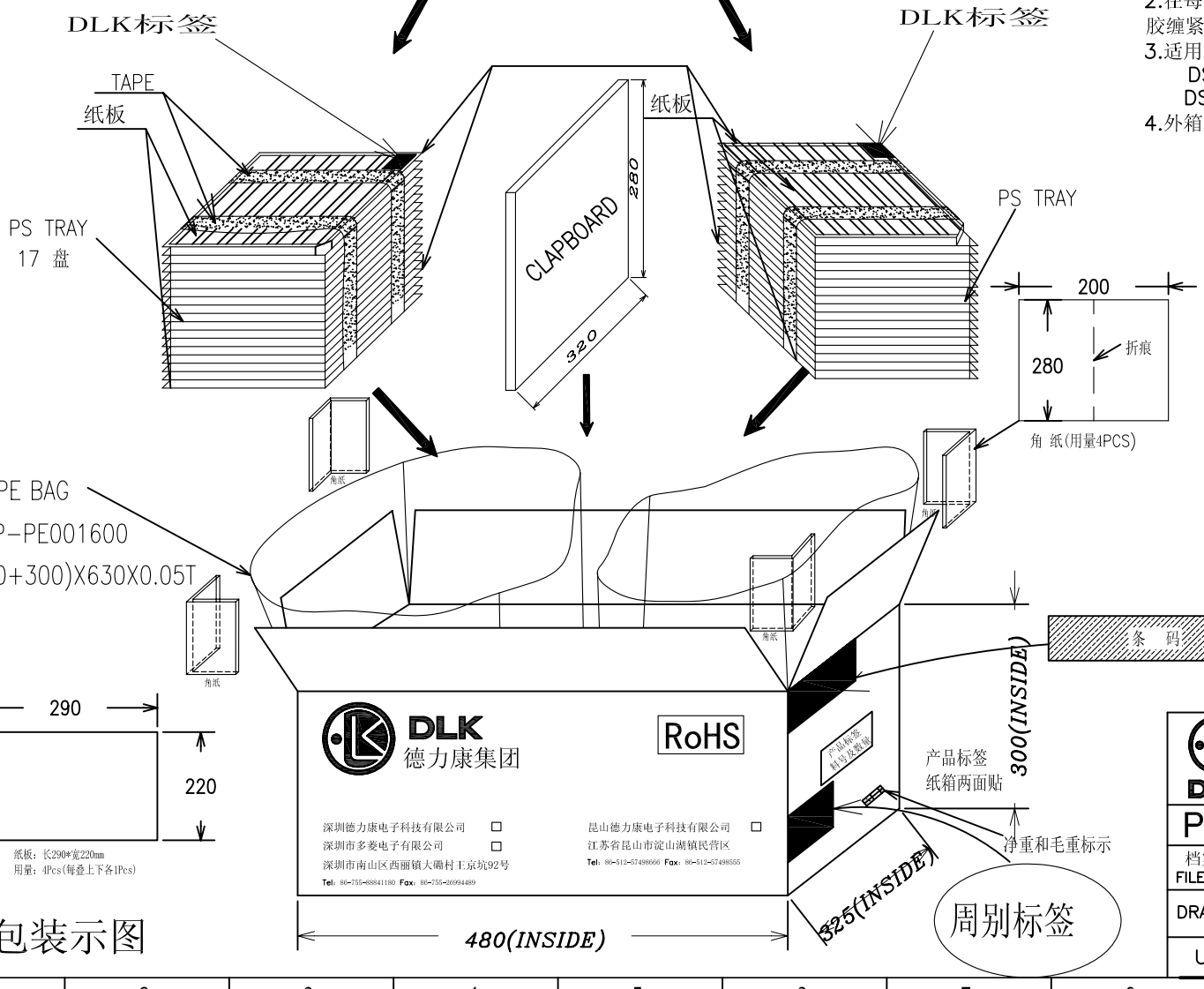
2.在每叠产品右上角帖标签，每叠上下各放一纸板并用透明胶缠紧;每叠需套一PE袋,加干燥剂，封口后放入纸箱;

3.适用料号:

DSB4WD-15LM1YN3P

DSB4WD-15LM1YN3PHF

4.外箱材质K=K,要求破裂强度为6Kg.



包装示图

名称	备注
纸箱尺寸	480*325*300
装箱数量	见上面说明
堆栈层数	5层
纸箱抗压耐破	6Kg
纸箱材质	K=K
包装后整箱数量	23.6Kg

名称	料号	规格
护角板	P-GB004200	(290L*220W)mm
PE袋	P-PE001600	(500+300)*630*0.05T(mm)
纸板	P-GB004500	(290L*220W)mm
纸隔板	P-GB004100	320L*280w)mm
吸塑盒底盒	P-PB008301	PS,T=0.8mm,(300L*225W*24H)mm
吸塑盒上盒	P-PB008201	PS,T=0.6mm,(300L*225W*24H)mm
纸箱	P-0C007400	(480*325*300)mm

德力康电子科技有限公司

DELIKANG ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD

P 名称 TITLE:	DSB4W 包装示意图		料号 PART NO:	DSB4WD-15LM1YN3*	
档案名称 FILE NAME.	P-DSB4W-00-00		PART NO: (OLD)	———	
DRAWING	王永辉	CHECKED	———	APPROVED	严成旺
UNIT	mm	SCALE	1:1	SHEET: 1 of 1	

Material BOM List

料件名稱/料號 ： DSB4WD-15LM1YN3P

廠商名稱 ： DLK　　版本 Version :A

Customer P/N :2K.24013.A15　　日期 Date ： 2015.02.11

依循國際標準或是協會標準:依据IEC60807-3协会规范

項目 ITEM	部位 Position description	廠商名稱 supplier	底材材質 Bottom material	FLAME , UL NO	顏色,色碼 Color , Number	底材主要組成 Component of Bottom material	第一層材質 Material of first layer	鍍層濃度範圍 Plating layer thickness	第二層材質 Material of Second layer	鍍層濃度範圍 Plating layer thickness
1	塑胶主体	泰塑/DLK	PBT	UL:E321019 UL94V-0	Blue					
2	后盖	泰塑/DLK	PBT	UL:E321019 UL94V-0	Black					
3	端子	广铜/DLK	C2680（H65）			Cu	Ni	50u"Min	接触端：Au 焊锡端：Matte Sn	接触端：1u"Min 焊锡端：100u"Min
4	外壳	德分/DLK	SPCC			Fe	Cu	50u"Min	Ni	80u"Min
5	叉脚	德分/DLK	SPCC			Fe	Ni	50u"Min	Sn	100u"Min
6	铆钉	骅杰/DLK	C3602			Cu	Ni	50u"Min		

Note = Paint thickness unit : u"

Approve:严成旺　　Check:N/A　　Prepare:丁沁

Need more information? **Click Here** to go to the UL iQ™ for Plastics database

Component - Plastics **E321019**

TAISU PLASTIFICATION MATERIAL SCI&TECH CO LTD

TAISU INDUSTRIAL ZONE, FENGXIN RD, GUANGMING NEW DISTRICT, SHENZHEN GUANGDONG 518107 CN

PBT T301 00 GF

Polybutylene Terephthalate (PBT), glass reinforced, furnished as pellets

Color	Min Thk (mm)	Flame Class	HWI	HAI	RTI Elec	RTI Imp	RTI Str
NC, RD, BK	0.4	V-0	4	1	75	75	75
ALL	0.8	V-0	3	1	75	75	75
	1.6	V-0	2	1	75	75	75
	3.0	V-0	0	1	75	75	75

Comparative Tracking Index (CTI): -

Inclined Plane Tracking (IPT): -

Dielectric Strength (kV/mm): **30**

Volume Resistivity (10^X ohm-cm): **18**

High-Voltage Arc Tracking Rate (HVTR): -

High Volt, Low Current Arc Resis (D495): -

Dimensional Stability (%): -

ANSI/UL 94 small-scale test data does not pertain to building materials, furnishings and related contents. ANSI/UL 94 small-scale test data is intended solely for determining the flammability of plastic materials used in the components and parts of end-product devices and appliances, where the acceptability of the combination is determined by UL.

Report Date: 2013-03-28

Last Revised: 2013-03-28

© 2013 UL LLC

IEC and ISO Test Methods

Test Name	Test Method	Units	Thickness Tested (mm)	Value
Flammability	**IEC 60695-11-10**	**Class (color)**	**0.4**	**V-0 (NC, RD, BK)**
			0.8	**V-0 (ALL)**
			1.6	**V-0 (ALL)**
			3.0	**V-0 (ALL)**
Glow-Wire Flammability (GWFI)	**IEC 60695-2-12**	**C**	**0.4**	**960**
			0.8	**960**
			1.6	**960**
			3.0	**960**
Glow-Wire Ignition (GWIT)	**IEC 60695-2-13**	**C**	**0.4**	**825**
			0.8	**825**
			1.6	**825**
			3.0	**825**
IEC Comparative Tracking Index	**IEC 60112**	**Volts (Max)**	**3.0**	**CTI2**
IEC Ball Pressure	**IEC 60695-10-2**	**C**	**-**	**-**
ISO Heat Deflection (1.80 MPa)	**ISO 75-2**	**C**	**-**	**-**
ISO Tensile Strength	**ISO 527-2**	**MPa**	**-**	**-**
ISO Flexural Strength	**ISO 178**	**MPa**	**-**	**-**

ISO Tensile Impact	**ISO 8256**	**kJ/m^2**	**-**	**-**
ISO Izod Impact	**ISO 180**	**kJ/m^2**	**-**	**-**
ISO Charpy Impact	**ISO 179-2**	**kJ/m^2**	**-**	**-**

© 2013 UL LLC

The materials covered in this database are incomplete in certain constructional features or restricted in performance capabilities and are intended for use as components of complete equipment submitted for investigation rather than for direct separate installation in the field. THE FINAL ACCEPTANCE OF THE COMPONENT IS DEPENDENT UPON ITS INSTALLATION AND USE IN COMPLETE PRODUCTS SUBMITTED TO UNDERWRITERS LABORATORIES.

Notice of Disclaimer

D-SUB CONN.測試項目管控LIST

Item	測試項目	重點管控	備註
1	接觸電阻	≦ 30m OHM	
2	絕緣電阻	≧ 5000 M OHM	
3	耐電壓	**500V AC 1min,** ~~	
4	尺寸	符合規格要求	
5	外觀	無變形, 無破損,無污穢,無氧化	
6	MARKING	清晰,完整	
7	插拔力	符合規格要求	
	Terminal strength	符合規格要求	
8	可焊性	Temperature ≦ 235 +/- 5℃ , Dip Time ≦ 2.5 +/- 0.5 sec. Requirement: 90 % COVERAGE以上	
9	耐焊接性	Temperature ≧ 260℃ Dip Time ≧ 10 +/- 0.5 sec Requirement: 符合RoHS 零件耐焊接熱標	
ORT 測試			
9	Salt Spray Test	Temperature : 35℃ Density: 5% , 48hr	
10	Durability(耐插拔)	Life cycles based on SPEC	

1. 電氣規格

1.1 料件工作溫度範圍

料件使用溫度範圍:-25℃～105℃.

1.2 料件最高工作溫度

料件最高溫度:105℃.

1.3 料件存儲溫度範圍

料件存儲溫度範圍:-20℃～100℃.

1.4 料件存儲期限

料件存儲期限:6 個月 （自产品出厂之日起储存期限为6个月）

1.5 料件工作電氣極限要求

額定電流:3.0 A 250V

接觸阻抗:30mΩ以下

絕緣阻抗:5000MΩ以上 500VDC

耐電壓:接觸璃間加電壓500V AC/1 分鐘以上,感度電流 1mA,不可有絕緣破裂.

機械壽命:500 CYCLES

PRODUCT SPECIFICATION

1.0 Applicable Connector: Applicable to DLK D-SUB Series connector.

（适用于德力康公司 D-SUB 系列连接器.）

Scope: This specification covers the requirements for product performance and test methods of DLK's D-SUB Series Connectors of the part numbers specified as bellow.

（覆盖范围：此规格书内容含盖德力康公司 D-SUB 系列连接器产品性能及测试方法。）

2.0 Rating（要求）：

2.1 Rated Voltage : 250 V AC,DC（额定电压：250V）

2.2 Rated Current:3.0 A（额定电流：3.0A）

2.3 Electric Pressure: Keeping 60 second in AC 500V/1mA(耐压 500V AC 持续 60 秒）

2.4 Insulation Resistance: 5000 MΩ Min. in DC 500V(绝缘阻抗最小 5000 兆欧)

2.5 Contact Resistance: 30 mΩ Max. (接触阻抗最大 30 毫欧)

3.0 Test Condition（测试条件）：

All tests shall be performed as bellow conditions unless otherwise specified.

（所有的测试都在下列条件下完成，除非另有说明.）

3.1 Temperature range : +15℃to35℃. （ 温度：+15℃至 35℃）

3.2 Humidity range: 25%to85%.（湿度：25%至 85%）

3.3 Atmospheric Pressure : 860 to 1060 mber

（大气压力： 860 至 1060 兆帕）

4.0 Mechanical Characteristics（机械性能）

4.1 Insertion Force(for one pin)：240gf/Max.

4.2 Extraction Force(for one pin): 30gf/Min.

4.3 Stretching Force(from insulator to pin):1.0Kgf/Min

4.4 Insertion Force(mating connector):2.0 to 5.0Kgf;

4.5 Extraction Force(mating connector):1.0Kgf Min

5.0 Test Methods and Requirements（测试方法和要求）：

5.1 Examination of product（检查尺寸）：

Item (条目)	Test Description （测试内容）	Test Methods （测试方法）	Requirement （要求）

5.1.1	Examination of product Outward Appearance Structure （产品外形/尺寸检查）	Shall be confirm with eyes in accordance with each drawing. Shall be confirmed by using proper measuring instruments. （依照图面要求对产品目视检查，再用测量工具，按图面要求测量尺寸）	Outward appearance shall be good without such injurious problem structure shall be meet the design and dimensional requirements of drawing （外观良好，无任何有害问题；结构符合图面设计要求。）

5.2 Electrical performance（电气性能）：

Item (条目)	Test Description （测试内容）	Test Methods （测试方法）	Requirement （要求）
5.2.1	Contact Resistance （接触阻抗）	Mated connectors. Contact: measure by dry circuit, 20 mvolts maximum., 10mA Shell: measured by open circuit, 5 Volts maximum, 100mA. (ANSI/EIA-364-06A-83) （配对的连接器，端子在回路施加直流最大 20mV 10mA 的电流；铁壳在回路施加直流最大 5V 100mA 的电流；再测量相对应端子或铁壳的电阻值）	Excluding conductor resistance : 30 mΩ maximum. （接触阻抗最大不能超过 30 毫欧）
5.2.2	DIP 脚之间接触阻抗	左 Dip 脚与右 Dip 脚之间 及 左右 Dip 脚分别与外铁壳 的电阻值	
5.2.3	Insulation Resistance （绝缘阻抗）	Unmated connectors, applied DC 500 Volts for 1minute between adjacent terminal. (ANSI/EIA 364-21, Method 302) （未交配的连接器，在相邻的端子间施加 DC 500V 的电压测试 1 分钟；）	5000MΩ minimum (unmated) （最小为 5000 兆欧）
5.2.4	Dielectric Strength （耐电压）	Unmated connectors, applied AC 500 Volts and leak current 1mA for 1minute between adjacent terminal . (ANSI/EIA 364-20,Method 301) （未交配的连接器，在相邻的端子间施加 AC 500V 的电压与 1mA 漏电流测试 1 分钟；	No Breakdown （没有损坏）

5.3 Mechanical Performance（机械性能）：

Item (条目)	Test Description （测试内容）	Test Methods （测试方法）	Requirement （要求）
5.3.1	Connector Insertion Force（插入力）	Solder each of the plug and receptacle connector to the P.C.Board then do insertion/extraction along the axis 3 times at speed 25mm. After place each of the P.C.Board onto the push-on/pull-off machine to be measurement the insertion force. (ANSI/EIA-364-13) （将公、母座焊接在 PCB 板上，再将 PCB 板置于插拔力实验机上，然后以每分钟 25mm 的速度沿轴向插拔 3 之次后再测试其插入力。）	Insertion force：2.0～5.0Kgf. 插入力： 2.0～5 .0Kgf.

5.3.2	Connector Withdrawal Force （拔出力）	Solder each of the plug and receptacle connector to the P.C.Board then do insertion/extraction along the axis 3 times at speed 25mm. After place each of the P.C.Board onto the push-on/pull-off machine to be measurement the insertion force. (ANSI/EIA-364-13) （将公、母座焊接在 PCB 板上，再将 PCB 板置于插拔力实验机上，然后以每分钟 25mm 的速度沿轴向插拔 3 之次后再测试其拔出力。）	Withdrawal Force：1.0Kgf Min. 拔出力： 1.0Kgf Min.
5.3.3	Durability （寿命）	Solder each of the plug and receptacle connector to the P.C. Board,then place each of the P.C. Board onto the push-on/pull-off machine,then do insertion / Withdrawal 500 cycles along the axis at speed of 100 ±50 cycles per hours （ANSI/EIA 364-09） （将公、母座焊接在 PCB 上，再将 PCB 板置于耐插拔实验机上，然后以每小时 100±50 次的速度沿轴向插拔 500 次）	1）Insertion force：2.0～5.0Kgf . 插入力： 2.0～5 .0Kgf . 2）Withdrawal Force：1.0Kgf Min. 拔出力： 1.0Kgf Min.
5.3.4	Terminal strength （端子强度）	Apply 5N gravity in the direction of the terminal of axis X,Y,Z for 10 seconds. After soldering and fixing the PC board properly, insert and withdraw 100 cycles. But the insertion force is 15N max. （在端子各方向加 5N 的重力（X，Y，Z 方向），时间 10 秒。焊接并固定好印刷线路板后，插拔 100 次。但插力在 15N 以下）	There are no crack,no damage,electrical performance normal. (端子无裂痕，损伤等；电气电能正常。)

5.4 Environmental Performance（环境性能）：

Item (条目)	Test Description （测试内容）	Test Methods （测试方法）	Requirement （要求）
5.4.1	Salt Spray （盐水喷雾）	Salt density:5% Temperature: 35± 2℃ 盐水浓度：5% 温度：35± 2℃ After keeping in above surrounding for 48 hours EIA-364-26	

膜厚類型	測試時間	判定
USB / DVI&D-SUB / DP CONN / HDMI / AC SOCKET		
鍍錫部位	24H	無氧化,銹蝕
鍍錫之焊錫部位	24H	
金属件與非金屬/折彎處/切口	24H	
外部連接 port	48H	
接觸端鍍金(包含 15u"與 15u"以上)	48H	
接觸端鍍金(包含 15u"以下上)	48H	

5.4.2	Withstand humidity （恒温恒湿）	Solder each of the plug and receptacle connector to the P.C.Board ,then mate them together and exposed at temperature of 40℃±2℃ and humidity of 90-95% for a period of 96 hours. after removal from chamber, socket shall be returned at room condition for a period of 2 hours. the socket shall be capable of. （ANSI/EIA-364-31） （将公母座连接器各自焊接于 PCB 板上后将其对插再暴露在温度为 40℃±2℃，湿度为 90-95%的恒温恒湿槽中放置 96 小时进行测试，完成测试后将插座取回在常温常湿下放置 2 小时后测定。）	1）Appearance: no damage（外观无损害） 2）Contact resistance: 30 mΩ Max. （接触阻抗最大 30 毫欧） 3）Insulation resistance: 5000 megaohms minimum. （绝缘阻抗最小 5000 兆欧） 4 ）dielectric withstanding Voltage: AC 500V No Breakdown. （耐电压 AC 500V 测试无损坏。）
5.4.3	Withstand heat （耐热）	The connector shall be exposed in a hot chamber at temperature of 70±2℃ for a period of 96 hours ,shall then be returned at room conditions for 2 hours. the socket shall be capable of satisfactory performance. （ANSI/EIA-364-17） (将连接器暴露在温度为 70±2℃的恒温恒湿槽中放置 96 小时后，再在室温下自然干燥 2 小时后，绝缘部分应无变形、裂痕、金属部分无变色。)	Appearance: no obvious damage on appearance and configuration （外观和构造无损坏）
5.4.4	Withstand cold （耐寒）	The connector shall be exposed in a cold chamber at temperature of -40℃±2℃ for a period of 96hours, shall then be returned at room conditions for 2 hours, the socket shall be capable of satisfactory performance. （ANSI/EIA-364-17） (将连接器暴露在温度为-40±2℃的恒温恒湿槽中放置 96 小时后，再在室温下自然干燥 2 小时后，绝缘部分应无变形、裂痕、金属部分无变色。)	Appearance: no obvious damage on appearance and configuration （外观和构造无损坏）
5.4.5	Composite temperature/humidity cyclic （高低温循环）	The socket shall be subjected to the condition described below, for a total of 5 cycles, first step -25℃±2℃/0.5h, second step: 85℃±2℃/0.5h ,shall then be returned at room condition for a period of 2 hours . （ANSI/EIA-364-17） (在下列条件下持续进行 5 次循环测试,第一步：-25℃±2℃/0.5h，第二步：85℃±2 ℃/0.5h，常温常湿中放置 2 小时后测定。)	1）Appearance: no damage（外观无损害） 2）Contact resistance: 30 mΩ Max. （接触阻抗最大 30 毫欧） 3）Insulation resistance: 5000 megaohms minimum. （绝缘阻抗最小 5000 兆欧） 4 ）dielectric withstanding Voltage: AC 500V No Breakdown. （耐电压 AC 500V 测试无损坏。）
5.4.6	Solderability （可焊性）	Immerse the solder pin of the connector in the solder bath at 235℃±5℃ for 2.5±0.5seconds. After dipped the pin in the flux for 5 seconds. （ANSI/EIA-364-52） （将端子脚浸入助焊剂中 5 秒，然后将端子脚浸入 235℃±5℃的锡炉中 2.5±0.5 秒.）	Solder wetting:90% of immersed area must show no voids，Pin holes. (粘锡面积：锡附着的面积应超过浸入表面积的 90%以上)
5.4.7	Resistance to soldering heat （耐焊接热）	Place the connector on the P.C.Board,then immerse the solder pin up to the surface of the board in the solder bath at 260℃+2℃ for 10±0.5 seconds.（ANSI/EIA-364-52） (将连接器置于 PCB 上,然后将露出 PCB 板表面的 Pin 脚部分浸入 260+2℃的锡炉中 10±0.5 秒)	1）Without deformation of case or excessive lossen.(塑胶不得有明显变形或损坏) 2）Electrical characteristics shall be satisfied.(电气特性必须符合规格)

5.4.8	Vibration （振动）	Solder each of plug and receptacle connector to the P.C.Board,then mate them together.place the mated connector firmly on the vibrator and apply the following condition shall be done. Amplitude:1.52 mm P-P or 147m/s2 {15G} Vibration frequency:10Hz-55Hz-10Hz/minute. Direction:along three mutually perpendicular direction. Sweep time:two hours along each direction,a total six hours. Electrical load: DC100ma current shall be flowed during the test. (ANSI/EIA-364-28) (将公母座各自焊接于 PCB 板上，然后将其对插再固定于振动机上，并施加下列条件) 振幅：1.52mm； 振动频率：一分钟内变换 10Hz-55Hz-10Hz； 方向：沿著三个互相垂直的方向； 时间：每个方向两小时，共 6 小时； 电力负载：施加 DC 100mA 电流测试。	1）No electrical discontinuity greater than 1 microsecond.shall occur. （电气上不能有超过 1 徼秒断讯的情形发生。） 2）Lossen,crack and breakage of the plastic part and other detrimental damage shall not be observed. （塑胶件不能有松脱破损或其它不利的损坏。） 3）Contact resistance: 30 mΩ Max. （接触阻抗最大 30 毫欧）

6.0 Test Sequence（测试顺序）：

Test Group (群组测试)		Sample Groups（群组样品）									
Test Item （项目）	Test Description （测试种类）	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
5.1.1	Examination of product(尺寸/外形检查)	1,9	1,9	1,5	1,7	1,3	1,3	1,9	1,3	1,3	1,5
5.2.1	Contact Resistance(接触阻抗)	3,7	2,6	2,4				2,6			2,4
5.2.2	Insulation Resistance(绝缘阻抗)		3,7		2,5			3,7			
5.2.3	Dielectric Withstanding Voltage(耐电压)		4,8		3,6			4,8			
5.3.1	Connector Insertion Force(插入力)	2,6									
5.3.2	Connector Withdrawal Force(拔出力)	4,8									
5.3.3	Durability(寿命)	5									
5.3.4	Terminal strength(端子强度)		5								
5.4.1	Salt Spray(盐水喷雾)			3							
5.4.2	Withstand humidity(恒温恒湿)				4						
5.4.3	Withstand heat(耐热)					2					
5.4.4	Withstand cold(耐寒)						2				
5.4.5	Composite temperature/humidity cyclic (高低温循环)							5			
5.4.6	Solderability(可焊性)								2		
5.4.7	Resistance to soldering heat(耐焊接热)									2	
5.4.8	Vibration(振动)										3
Number of Test Samples (Minimum)最小试样数量		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

环境管理物质不使用证书
（原材料及原材料厂家 LIST）

向贵司销售的零部件及组件的使用材料、包装材料等中未使用 **DLK**《环境管理物质技术标准》（**508000-D-002**）要求的管理物质（禁止使用对象）及其用途，特此证明。

且：零部件及组件的使用在材料，由以下成分构成。特此报告

1.零件料号：DSB4WD-15LM1YN3P

以下清单所列均质原材料为本产品中所用到的所有原材料

ITEM	Raw Material	Raw Material Supplier	Cd	Pb	Cr^{6+}	Hg	PBB/PBDE	Cl	Br	PAHs	第三方测试报告号码
			含量(ppm)	含量(ppm)	含量(ppm)	含量(ppm)	含量(ppm)	含量(ppm)	含量(ppm)	含量(ppm)	
Housing	PBT	泰塑/DLK	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D				SCL01G45364001
Cover	PBT	泰塑/DLK	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D				SCL01G003978002
Contact/ Board Luck	C2680（H65）	广铜/DLK	N.D	20	Negative	N.D					CANML1404420501
Shell/ Shielding Case	SPCC	德分/DLK	N.D	N.D	Negative	N.D	N.D				RHS05F019183001
Rivet	C3602	骅杰/DLK	9	23708	Negative	N.D	N.D				SHAEC1420915204
Plating Ni	Ni	长风/DLK	N.D	15	Negative	N.D		N.D	N.D		SHAEC1414151604
Plating Sn	Matte Sn	长风/DLK	N.D	49	Negative	N.D		N.D	N.D		SHAEC1414151608
Plating Au	Au	同心/DLK	N.D	110	Negative	N.D					ECL01G029554002E
Plating Sn	Sn	长风/DLK	N.D	41	Negative	N.D		N.D	N.D		SHAEC1414151606

2、 ICP 测试对象物质（塑料（含橡胶）涂料、油墨和线材料中的镉和铅）测试要求的 ICP 数据另附。ICP 测试对象物质的成分表或 MSDS 另附。

备注：请填写该类零部件用到的所有部件、原材料、辅助材料的详细信息。

必须详细、正确的填写部件、原材料、辅助材料的供应商名称、材料型号

主管/职位：管理者代表

公司全称：德为康电子科技有限公司

公司公章：